证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-050

锦州神工半导体股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据公司2026年第二次临时股东会的授权,本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

本次发行预案(修订稿)及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,发行预案(修订稿)所述公司本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-051

锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。根据公司2026年第二次临时股东会的授权,本次调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定,并结合公司实际情况,公司对本次发行方案进行了调整,并调整本次发行的拟募集资金规模。公司本次发行方案的具体调整内容如下:

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	–	更新了“修订的董事会决议”、“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
2	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
3		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了“最新的第一大股东股份数及其持股比例”
4		八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了“修订的董事会决议”
5	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”
6		二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了“三个募投项目的募集资金投资净额及项目审批进度”
7	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
8		六、本次股票发行相关风险说明	更新了“截至2026年6月30日的财务数据”
9	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响、填补的具体措施及相关的主体承诺	更新了“拟投入扣除发行费用后的募集资金净额”、“2026年截至6月30日,研发人员人数及占比、专利数量”

本次向特定对象发行A股股票预案(修订稿)及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-052

锦州神工半导体股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开第三届董事会第十四次会议、于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了公司关于2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》(以下简称“发行预案(修订稿)”)等相关公告,敬请广大投资者注意查阅。

本次发行预案(修订稿)及相关文件披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册,发行预案(修订稿)所述公司本次发行相关事项尚需上海证券交易所审核并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况,按照有关法律法规及时履行相应的审议程序以及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-053

锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月13日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了关于公司2026年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的相关议案。2026年9月9日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告(2015)31号)等文件的有关规定,公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过81,028.32万元(含本数),本次发行完成后,公司的总股本和净资产将有较大幅度的增加,由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和时间,短期内公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险,具体影响测算如下:

(一)财务指标计算的主要假设和前提

公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析:

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营环境及产品市场情况等方面没有发生重大变化;

2、假设本次发行方案于2026年11月末实施完毕。该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不构成对本次发行实际完成时间的判断,最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准;

3、假设发行数量为17,030,574股(以预案出具日公司总股本170,305,736股的10%测算),募集资金总额为81,028.32万元,本测算不考虑相关发行费用;本次向特定对象发行股票数量及募集资金规模将根据监管部门审批、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润等之外的其他因素对净资产的影响;

5、公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为10,203.71万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为10,032.24万元;

6、假设公司2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润按以下三种假设进行测算:1)较2025年减少10%;2)与2025年持平;3)较2025年增加10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

7、假设2026年除本次发行外,不存在其他导致公司总股本变化的因素;

8、不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2026年盈利情况的承诺,也不代表公司对2026年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,本次发行对公司主要财务指标的影响测算对比如下:

项目	2025年度/2025.12.31	2026年度/2026.12.31	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本(万股)	17,030.57	17,030.57	18,733.63
本次发行股份数量(万股)			1,703.06
假设情形一:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年减少10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	9,183.34	9,183.34
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	9,029.02	9,029.02
基本每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.54	0.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.53	0.53
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.53	0.53
假设情形二:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润与2025年持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	10,203.71	10,203.71
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	10,032.24	10,032.24
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.60	0.59
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.58
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.59	0.58
假设情形三:2026年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2025年增加10%			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,203.71	11,224.08	11,224.08
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,032.24	11,035.47	11,035.47
基本每股收益(元/股)	0.60	0.66	0.65
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.66	0.65
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.59	0.65	0.64
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.59	0.65	0.64

注:每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算。

二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加,由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,可能在短期内难以实现预期效益,从而存在本次发行完成后每股收益被摊薄的风险。此外,一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被摊薄的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期股东回报的风险。

三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性

本次募集资金投资项目经过了严格的论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力和风险抵御能力,具有充分的必要性和可行性。

关于本次向特定对象发行募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析,详见《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》之“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务关系

本次向特定对象发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于主营业务相关项目建设,募集资金投资项目属于围绕现有业务的固有产品及新产品研发、技术升级与产品结构优化,有望进一步丰富公司产品矩阵,提高公司核心竞争力,增强可持续盈利能力,促进公司高质量转型发展。

公司为国内领先的硅材料、硅零部件生产企业之一,本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及公司未来整体战略发展方向,有利于提升公司的综合实力,对公司的发展战略具有积极作用。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨,以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念,致力于成为有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀半导体材料和半导体零部件供应商。公司将继续瞄准了国际半导体行业,引进有着丰富生产、管理经验的复合型专家;同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员;巩固并加强中国本土技术人才梯队,提升公司的人才竞争优势。截至2026年6月末,公司研发人员85人,占员工总数量的20.68%,主要研发人员均有丰富的行业工作经验。

技术储备方面,公司聚焦“硅零部件精密加工”、“半导体碳化硅涂层技术”两大核心方向,同步强化工艺智能化管控领域布局,深耕半导体级单晶硅材料及应用产品赛道,研发成果丰硕,专利申请与授权工作稳步推进,进一步夯实了公司“材料+零部件”一体化核心竞争优势,为业务高质量发展提供有力技术支撑。公司在硅零部件上的技术储备十分丰富,已有20余项核心技术。截至2026年6月30日,公司拥有111项专利,其中22项为发明专利,89项为实用新型专利。公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等多项证书,充分证明公司的技术储备及研发实力。

市场储备方面,公司已取得了中国本土硅零部件市场的领先地位,已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链。公司已扎根于分工严密的国际半导体供应链中,将硅材料直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商,例如美国泛林集团(Lam Research)和日本东电电子(Tokyo Electron Limited,TEL),并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商,下游产业链丰富且实力雄厚。同时公司已取得本土硅零部件市场的领先地位,已进入了中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂的供应链,以高端品类为主,发挥了独特的国产化作用,市场空间潜力大。

综上所述,公司拥有充足的人员、技术和市场储备,为顺利推进募集资金投资项目提供了充分保障。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次发行募集资金的有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,提高公司未来的回报能力,公司拟采取一系列措施以提升公司经营业绩,为股东持续创造回报,具体如下:

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范、有效使用

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。本次募集资金到位后将存放于公司董事会决议开设的专项账户,并与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,确保募集资金专款专用。同时,公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定,在进行募集资金投资项目时,严格履行资金支出审批手续,明确各控制环节的相关责任,按项目计划申请、审批、使用募集资金,并及时履行相关信息披露义务。

(二)积极、稳妥地实施募集资金投资项目,实现项目预期回报

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略,可有效提升公司业务实力、技术水平,从而进一步巩固公司的市场地位,提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前期的可行性研究工作,对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况,最终拟定了项目规划。本次募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目的实施,争取早日投产并实现预期效益。

(三)不断完善公司治理,进一步提高经营管理能力

公司已建立健全了内部管理体系,能够保证公司各项经营活动得到有序开展。公司未来将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,不断完善公司治理结构,进一步提高经营管理能力,完善决策程序、优化管理流程、强化执行监督,促进公司规范运作,全面提升公司的经营效率和效果,保护公司和投资者的合法权益。

(四)持续完善内部控制,加强资金使用管理和对管理层考核

公司将进一步完善内部控制,加强资金管理,防止资金被挤占挪用于非经营性活动,提高资金使用效率;严格控制费用支出,加大成本控制力度,降低运营成本,提升公司利润率;加强对管理层的考核,将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩,确保管理层恪尽职守,勤勉尽责,保障公司持续、稳定、健康发展。

(五)完善利润分配政策,优化投资者回报机制

公司制定了详细的利润分配原则、利润分配规划与计划、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配的比例、利润分配的决策程序和机制、分配利润的发放、利润分配政策的信息披露、利润分配政策的调整机制;在具备现金分红的条件下,公司应当优先采取现金方式分配股利,且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。此外,公司还制定了《锦州神工半导体股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,进一步明确了未来三年(2026-2028年)的利润分配政策,积极落实对股东的利润分配,促进对投资者持续、稳定、科学的回报,切实保障投资者的权益。

(六)其他方式

公司承诺未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求,持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

此外,公司提示广大投资者,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

六、相关主体对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺

公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出承诺如下:

1、在任何情况下,不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、对本人的职务消费行为进行约束,在职务消费过程中本着节约原则行事,不奢侈、不铺张浪费;

3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;

4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施股权激励计划,股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、本承诺出具日后,如中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定的,本人届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺;

7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;同时,若因违反该等承诺给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-049

锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据公司股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权,现对公司2026年度向特定对象发行A股股票方案中募集资金规模进行调整。具体如下:

原内容:

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过100,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	50,000.00
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	30,000.00
3	研发中心建设项目	20,643.13	20,000.00
合计		108,528.84	100,000.00

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

调整为:

募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过81,028.32万元(含81,028.32万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入扣除发行费用后的募集资金净额
1	硅零部件扩产项目	57,747.25	41,369.28
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	30,138.46	23,659.04
3	研发中心建设项目	20,643.13	16,000.00
合计		108,528.84	81,028.32

在本次发行募集资金到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自有或自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

(三)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况,公司对《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况,公司对《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》。

(五)审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况,公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

(六)审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)的议案》

根据本次发行方案调整等相关情况,公司对《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》进行了修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-054

锦州神工半导体股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)[2026]169号)(以下简称“《问询函》”)。

上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对募集说明书等申请文件进行了修订和完善,根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(豁免版)》《锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-068
转债代码:110817 转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司2026年8月份销售情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年8月,公司实现签约面积78.33万平方米,同比减少16.67%;签约金额150.13亿元,同比减少16.67%。

2026年1-8月,公司实现签约面积788.25万平方米,同比减少12.27%;签约金额1650.42亿元,同比减少8.92%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十日

证券代码:600048 证券简称:保利发展 公告编号:2026-067
转债代码:110817 转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2026-062)披露以来,公司新增加房地产项目1个,项目信息如下(具体位置详见附图):

单位:平方米、万元

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率面积	我方需支付价款	权益比例
1	东莞市南城区东莞大道北侧地块	招拍挂	住宅	67,803	142,386	326,578	100%
合计		/	/	67,803	142,386	326,578	/

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月十日

图1:东莞市南城区东莞大道北侧地块

证券代码:900929 证券简称:锦旅B股 公告编号:2026-020

上海锦江国际旅游股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年09月16日(星期三)15:00-17:00

● 会议召开地点:“全景路演”网站(网址:https://rs.p5w.net)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 投资者可于2026年09月16日(星期三) 14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或通过公司邮箱wuxh@jltravel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导,上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次业绩说明会将以网络互动形式召开,公司将就2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月16日(星期三)15:00-17:00

(二)会议召开地点:“全景路演”网站

(网址:https://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司首席执行官:辛作伟先生

公司财务负责人:周峡先生

公司董事会秘书:吴兴华先生

公司独立董事:黄海杰先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)本次活动将采用网络文字互动的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

(二)投资者可于2026年09月16日(星期三) 14:00前访问https://ir.p5w.net/zj/或通过公司邮箱wuxh@jltravel.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会秘书办公室

电话:021-32128021

邮箱:wuxh@jltravel.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过“全景路演”网站或关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP,查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码:皖维高新 证券简称:600063 公告编号:临2026-078

安徽皖维高新材料股份有限公司关于参加2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

为进一步加强与投资者的互动交流,安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由安徽证监局指导,安徽上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司协办的“2026年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号“全景财经”,或下载“全景路演”APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年9月17日(周四)15:30-17:00。公司参会人员有董事、总经理向学毅先生、独立董事曹崇延女士和董事会秘书史方圆先生。届时公司高管将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

安徽皖维高新材料股份有限公司
2026年9月11日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-044

东方证券股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

活动时间为2026年9月16日(周三)15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月16日(周三)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集